



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 セイコーホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中村 吉伸  
(コード番号 8050 東証第 1 部)  
問合せ先 経理部長 瀧沢 観  
(TEL 03-6739-3111)

半導体事業の新会社設立に関する基本合意書の締結について

本日、当社の子会社であるセイコーインスツル株式会社（代表取締役社長：村上 斉、本社：千葉県千葉市美浜区／以下、SII）は、添付のとおり、株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：橋本 徹、本社：東京都千代田区）と両社の共同出資により半導体事業の新会社を設立し、SII の半導体事業を新会社へ移管するとともに、両社が協働して新会社の運営を行うこと等についての意向を確認する基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、詳細につきましては確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上

2015年5月12日

## 半導体事業の新会社設立に関する基本合意書の締結について

セイコーホールディングス株式会社  
セイコーインスツル株式会社  
株式会社日本政策投資銀行

セイコーホールディングス株式会社（代表取締役社長：中村 吉伸、本社：東京都港区／以下、SHD）の子会社であるセイコーインスツル株式会社（代表取締役社長：村上 斉、本社：千葉県千葉市／以下、SII）と、株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：橋本 徹、本社：東京都千代田区／以下、DBJ）は、両社の共同出資により半導体事業の新会社を設立し、SIIの半導体事業（以下、対象事業）を新会社へ移管するとともに、両社が協働して新会社の運営を行うこと（以下、本件取引）等についての意向を確認する基本合意書を締結しました。

今後、SIIとDBJは、本件取引に関して法的拘束力を有する正式契約を、2015年7月中を目処に締結することを目標に、対象事業の精査を経た上、詳細な条件について協議してまいります。その後、関係当局の必要な承認および認可の取得等を条件として、本件取引の2015年度第3四半期中の実行を目指します。

### 1. 本件取引の背景及び目的

SHDは、2014年3月期を初年度とする第5次中期経営計画を策定し、「事業収益の最大化に向けてウオッチ事業を中核に事業ポートフォリオを再構築すると共に、経営基盤の質的強化を実現する」を基本方針として、その戦略・課題に取り組んでおります。

対象事業であるSIIの半導体事業は、時計関連技術をベースに、EEPROMや電源ICなどのアナログ半導体をはじめとする優れた製品を提供してきました。同事業は、その高い収益性ととともに、グローバル・トップクラスの技術・人材・知的財産・顧客基盤等の経営資源や市場での競争ポジションを最大限に活かすことにより、更なる成長が期待できる事業です。しかしながら、今後、グローバルでの競争激化が進む半導体市場での持続的な成長のためには、大規模な設備投資や研究開発が不可欠であり、かつ収益変動リスクも大きいことから、自社単独での事業推進に加えて、他社とのアライアンスの可能性について検討を行ってまいりました。今回のDBJとの取り組みが、対象事業のさらなる拡大・成長につながるものであると判断し、基本合意に至りました。

新会社は、製造能力拡大・開発機能強化を図りながら、M&Aやアライアンス等を含めた業界再編を成長戦略の中核として推進し、半導体業界においてグローバル・プレゼンスを有する事業体（とりわけ、アナログ半導体を中心とした対象事業の主力分野では、世界トップ5位以内）になることを目指します。DBJは、「成長戦略支援のための付加価値創造型エクイティ投資（VG投資プログラム）」の一環として、新会社に対し、資金面での支援に加え

て、M&A 戦略、資本戦略等の分野を中心にそのノウハウやサポートを提供し、新会社の成長に貢献します。

## **2. 本件取引の概要**

本件取引では対象事業の分社化に際して、SII が新会社の 60%持分を、DBJ が 40%持分を保持する予定です。将来的には DBJ が 70%持分を取得することも視野に入れております。当面は、SII が継続して新会社の一定持分を保持することで、対象事業の円滑な経営・事業体制を確立し、DBJ との取り組みにより新会社の成長と収益の拡大を図り、SII 及び SHD グループ全体の中長期的な企業価値向上に貢献することを目指しております。

以 上